

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年5月14日(14.05.2021)



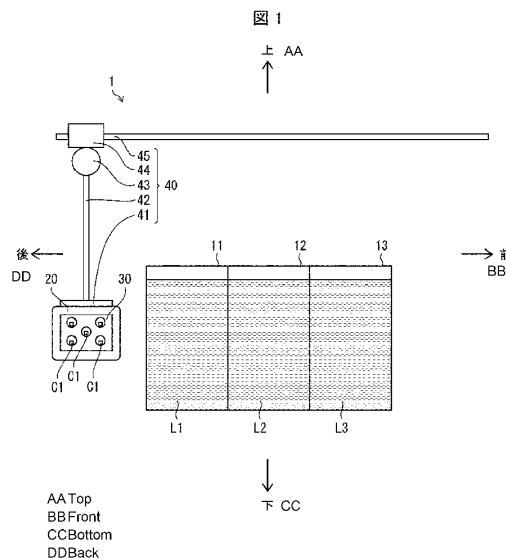
(10) 国際公開番号

WO 2021/090565 A1

- (51) 国際特許分類:
B08B 3/04 (2006.01) *C23F 1/24* (2006.01)
C01B 33/021 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/033525
- (22) 国際出願日: 2020年9月4日(04.09.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-200799 2019年11月5日(05.11.2019) JP
- (71) 出願人: 株式会社 トクヤマ (TOKUYAMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 阪井 純也 (SAKAI, Junya); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 横瀬 卓矢 (YOKOSE, Takuya); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社 トクヤマ内 Yamaguchi (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 H A R A K E N Z O W O R L D P A T E N T & T R A D E M A R K (HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

(54) Title: ETCHING DEVICE FOR SILICON CORE WIRE AND ETCHING METHOD FOR SILICON CORE WIRE

(54) 発明の名称: シリコン芯線のエッチング装置およびシリコン芯線のエッチング方法



(57) Abstract: Provided is a device capable of uniformly etching the entire surface of a silicon core wire. An etching device (1) for silicon core wires (C1, C2, C3) is provided with: etching solution tanks (11, 12) for holding etching solutions (L1, L2); multiple core wire support members (31), which are for supporting the silicon core wires (C1, C2, C3) and which have a hole (31A) through which the silicon core wires (C1, C2, C3) pass; and a position-changing mechanism (40) that changes the relative position at which the silicon core wires (C1, C2, C3) pass through the hole (31A).

[続葉有]

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: シリコン芯線の表面全体を均一にエッチングできる装置を提供する。シリコン芯線 (C 1、C 2、C 3) のエッチング装置 (1) は、エッチング液 (L 1、L 2) を収容するエッチング液槽 (1 1、1 2) と、シリコン芯線 (C 1、C 2、C 3) が貫通する孔 (3 1 A) が形成され、シリコン芯線 (C 1、C 2、C 3) を支持する複数の芯線支持部材 (3 1) と、孔 (3 1 A) に対してシリコン芯線 (C 1、C 2、C 3) が貫通する相対位置を変化させる位置変化機構 (4 0) と、を備える。